

# JPCA Show 2019 へ出展いたします

## 出展概要 Information about the exhibition

- ▶ **会期：2019年6月5日(水) - 7日(金)**  
**10:00~17:00 (最終日のみ16:00)**

>Dates and time: Jun. 5(Wed) to 7 (Fri), 2019  
10:00 to 17:00 (The last day is 16:00)

- ▶ **会場：東京ビッグサイト**

>Venue: Tokyo Big Sight, Tokyo, JAPAN

- ▶ **小間番号：西3ホール 3-204**

>Booth Number: West hall 3, 3-204

## ウエムラブース内プレゼンテーションのご案内

弊社の研究所員が、プレゼンテーションを行います。

### 6月5日(水)

テーマ：ファインパターン対応無電解Au/Pd/Auプロセス (IGEPiG)

### 6月6日(木)

### 6月7日(金)

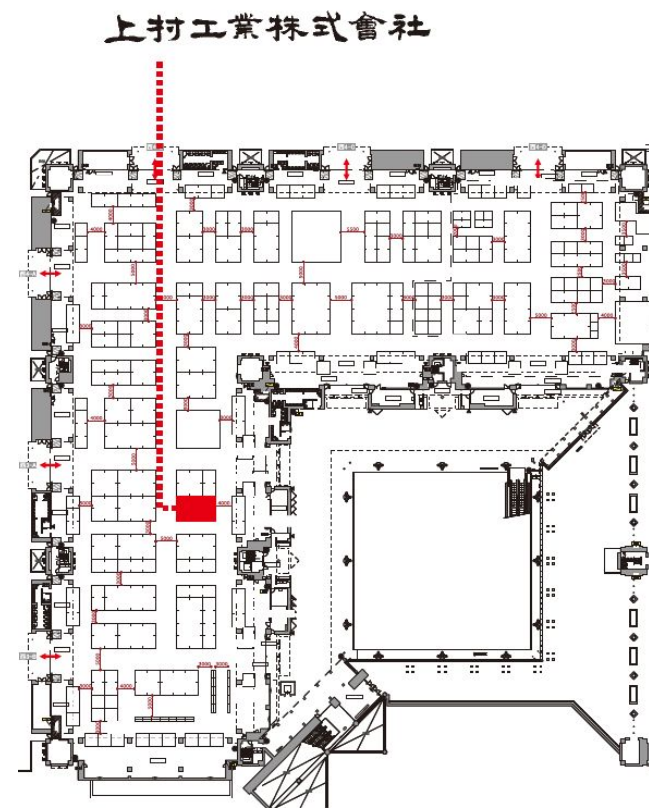
テーマ：①FO-PLP銅ポスト用硫酸銅めっき添加剤

スルカップ® EST-01

微細パターン用硫酸銅めっき添加剤

スルカップ® EMB-02

テーマ：②UBMめっき装置 スピードプレーター® UBM



西3ホール

## 次世代高密度回路技術を サポートするめっき薬品

電子機器の小型化・高機能化により銅回路の更なる高密度化および高速化が期待されています。このようなプリント配線板の銅回路形成では「ロープロファイル絶縁樹脂への高密着性を実現したデスマプロセス」や「ファインパターン形成に適した薄く均一な下地無電解銅めっきプロセス」、「穴埋め性および膜厚分布の均一性に優れたビアフィル電気銅めっき」等が求められています。ファインパターン銅回路形成に対するこれらの技術を提案いたします。

### セミアディティブ工法低粗度樹脂対応デスマ/ 無電解銅前処理プロセス

アップデス® プロセス & アルカップ® プロセス

### ファインパターン SAP 対応無電解銅めっき浴 スルカップ® PEAV6

### BVH 内めっき付き回り性向上無電解銅めっき浴 スルカップ® PTU

### 微細パターン用硫酸銅めっき添加剤

スルカップ® EMB-02  **NPI プレゼンテーション** 

### パターン&ビア/スルーホールフィリング用 硫酸銅めっき添加剤

スルカップ® EVF-YF4  **NPI プレゼンテーション** 

### FO-PLP 銅ポスト用硫酸銅めっき添加剤 スルカップ® EST-01

### 新方式垂直連続搬送めっき装置 U-VCPS

### UBM/PLP めっき装置

スピードプレーター® UBM / EC

## フレキシ基板への高い信頼性を サポートするめっき薬品

電子機器の薄膜化や軽量化によりフレキシブル基板およびリジットフレックス基板においても、銅回路の更なる高密度化と高速化に伴い高レベルの銅銅間接続信頼性が求められます。積層銅箔および内層銅上に導電性皮膜を形成せず、導電性銅合金薄膜を樹脂にのみ形成することにより直接硫酸銅めっきを行なうプロセスを提案いたします。また、FPC向けに耐折り曲げ性に優れた「高耐食性無電解めっき浴」を提案いたします。

### ダイレクトめっきプロセス パラダイム® プロセス

### フレキシブル基板対応無電解 Ni/Au プロセス

ニムデン® NPG-1 (ver.MT)、ゴブライト® TLM-44、  
ナノシーラー® MSL-17

## プレゼンテーションのご案内

### ▶ブース内プレゼンテーション

弊社の研究所員が、プレゼンテーションを行います。  
質問等も可能ですので、ぜひお立ち寄りください。  
※詳細はホームページをご覧ください。

### ▶NPIプレゼンテーション (出展社製品技術セミナー)

NPIプレゼンテーションに参加いたします。  
予約の必要はございません。お気軽にお立ち寄りください。

■日時：6月7日(金) 10:50～11:20

■会場：西展示ホール内2F 西2商談6<NPI会場B> (入場無料)

■タイトル：ETS用電気銅めっき浴

■問い合わせ先：cpd@uyemura.co.jp

ぜひお立ち寄りください。



こちら以外にも各種資料をご用意しております。  
今回の展示にない製品につきましてもお気軽に声をおかけください。  
スタッフ一同、皆さまのご来場をお待ちいたしております。

## 多様化する実装技術を サポートするめっき薬品

電子部品における“良好な接合信頼性”を維持できる最終表面処理が必要とされてきました。近年、電子機器の小型化に対応し、接合部分の微細化が急激に進んでいます。これらの背景を踏まえて、「微細配線パターンに対応できる無電解めっき浴」、「新規接合方式に対応できる無電解めっき浴」、「微小パッドや微小チップに対応できる電気すずめっき浴」、「次世代接合材向けめっき浴」等、様々な基材に対応できる前処理薬液も含めて提案いたします。

### フリップチップパンプ用すずめっきプロセス

エルスタナー® GLK-03 (conformal bath)

エルスタナー® GKH-22 (filling bath)

### シアンフリー無電解金めっき浴

ゴブライト® TNC-25 / TNC-45

### シアンフリー電気銀めっきプロセス

サブレア® GPS プロセス

### チップ部品へのニッケル/中性すずめっきプロセス

ニッケル：サブレア® ニッケル AEP-1

すず：ティナデス® GAM-1

### ファインパターン向け前処理プロセス

### 無電解 Ni/Pd/Au プロセス (ENEPIG) 用 パラジウムめっき浴

Pd-P 皮膜：アルタレア® TPD-35

純 Pd 皮膜：アルタレア® TPD-21

### ファインパターン対応無電解 Au/Pd/Au プロセス (IGEPiG)

### ニッケルフリーによる伝送損失の影響

### 電気金めっき浴自動液管理装置

ケミロボ® 3 EAU